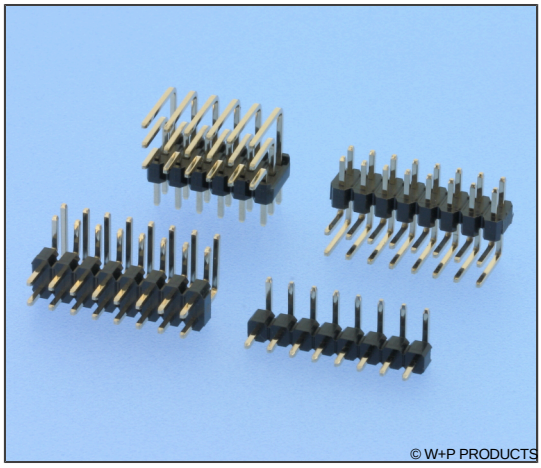
946 / 947 / 948

Stiftleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-/3-reihig

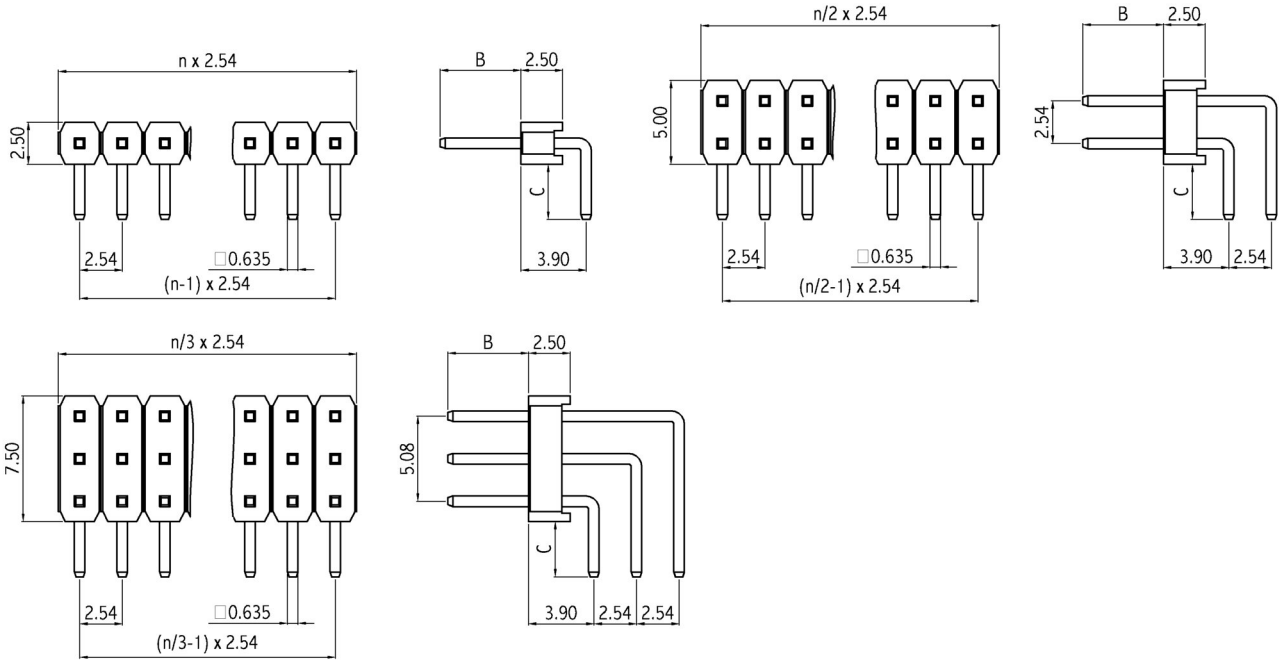
Pin Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, 1/2/3 Rows

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	*0.635mm square pin, copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*none*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Withstanding Voltage	*1 kV DC*
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	*250 V AC*
Nennstrom	3 A
Current Rating	*3 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*



Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*	***Dimensions****	***Contacts****	***Plating****
947	**12**	**010**	**00**
Gestanzte/geprägte Kontakte *Stamped/formed contacts* **946** Einreihig *Single row* **947** Zweireihig *Double row* **948** Dreireihig *Triple row*	**12** B=3,50 C=3,30mm **13** B=4,80 C=3,30mm **14** B=6,10 C=3,30mm **15** B=6,90 C=3,30mm **16** B=9,90 C=3,30mm **17** B=12,00 C=3,30mm **18** B=13,80 C=3,30mm **19** B=15,00 C=3,30mm **20** B=17,10 C=3,30mm	**001-050** Einreihig *Single row* **004-100** Zweireihig *Double row* **009-120** Dreireihig *Triple row*	**00** Au flash **110** Sel. Au 0,25µm / Au flash **130** Sel. Au 0,75µm / Au flash **50** Sn **66** Sel. Au flash / Sn **610** Sel. Au 0,25µm / Sn **80** Sel. Au 0,75µm / Sn Au flash <= 0,1µm *Au flash <= 0,1µm*

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.
Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie
weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.
Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter
Techn. Informationen.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

We will manufacture pin headers in the desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.

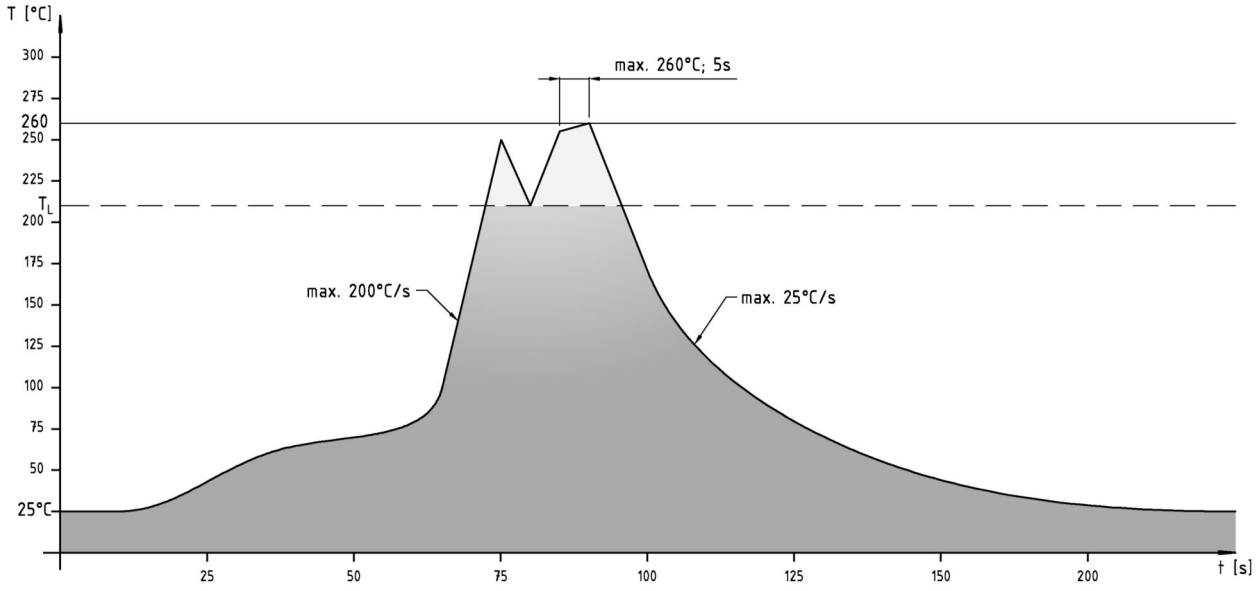
Downloaded from Arrow.com.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Downloaded from Arrow.com.

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

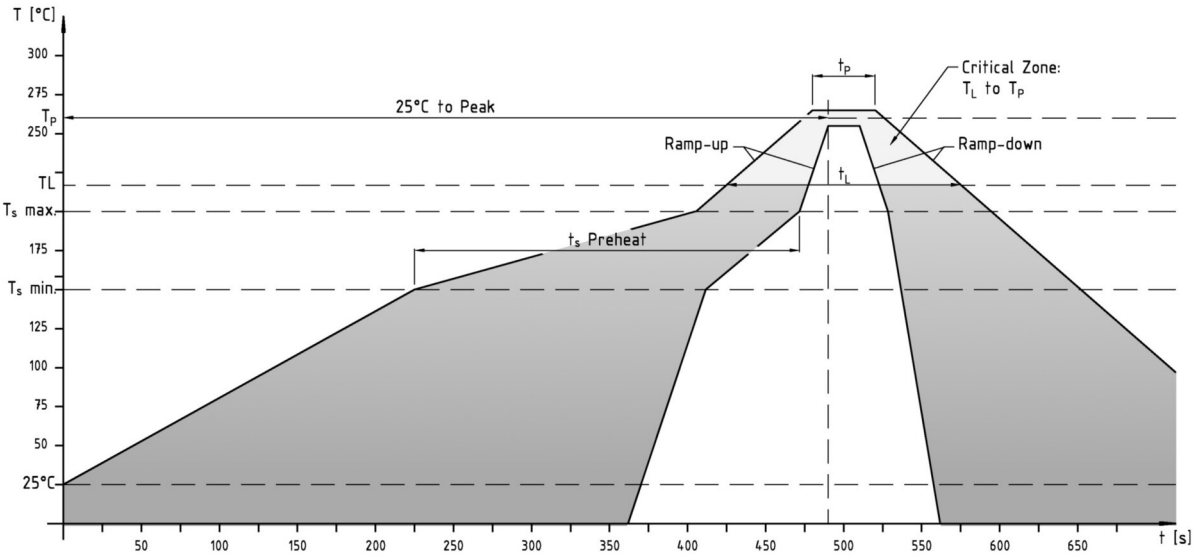
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*



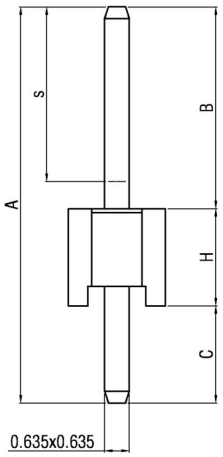
Downloaded from Arrow.com.

143 - 151 / 943 - 951 / 921 - 934

Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

A : Gesamtstiftlänge / *Overall Pin Length*
B : Länge Steckseite / *Mating Side Length*
C : Länge Lötseite / *Solder Side Length*
H : Höhe Isolierkörper / *Insulator Body Height*
s : Bereich der sel. Veredelung / *Sel. Plated Area*

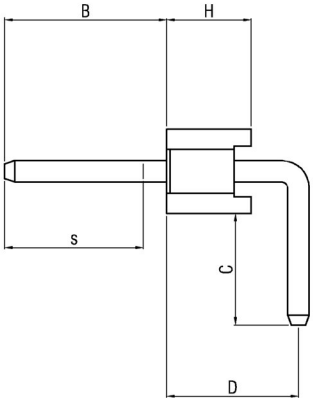
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
Test point for s at 2-4mm from contact tip.



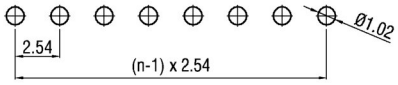
Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

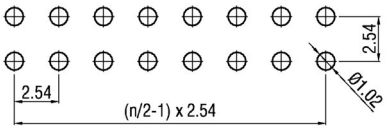
B : Länge Steckseite / *Mating Side Length*
C : Länge Lötseite / *Solder Side Length*
D : Abstand zu Steckseite / *Distance to Mating Side*
H : Höhe Isolierkörper / *Insulator Body Height*
s : Bereich der sel. Veredelung / *Sel. Plated Area*

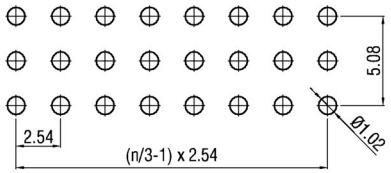
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.
Test point for s at 2-4mm from contact tip.



PCB Layouts







Downloaded from Arrow.com.